

Title (en)

ACID BATH FOR THE GALVANIC DEPOSITION OF COPPER, AND THE USE OF SUCH A BATH.

Title (de)

SAURES BAD ZUR GALVANISCHEN ABSCHIEDUNG VON KUPFER UND DESSEN VERWENDUNG.

Title (fr)

BAIN ACIDE DE DEPOT GALVANIQUE DE CUIVRE ET SON UTILISATION.

Publication

EP 0598763 A1 19940601 (DE)

Application

EP 92916259 A 19920722

Priority

- DE 4126502 A 19910807
- DE 9200605 W 19920722

Abstract (en)

[origin: US5433840A] PCT No. PCT/DE92/00605 Sec. 371 Date Apr. 6, 1994 Sec. 102(e) Date Apr. 6, 1994 PCT Filed Jul. 22, 1992 PCT Pub. No. WO93/03204 PCT Pub. Date Feb. 18, 1993. An aqueous acid bath for the galvanic deposition of bright, ductile and smooth copper coats which is suitable for decorative purposes as well as for strengthening the conductors of printed circuits. The bath is characterized by a content of polyalkylene glycol ether. When combined with thio compounds containing water-soluble groups, these additions produce an electrolyte with excellent stability. Polymeric phenazonium compounds, polymeric nitrogen compounds and/or thio compounds containing nitrogen may also be successfully combined, in addition, depending on the desired properties.

Abstract (fr)

Un bain acide aqueux sert à provoquer le dépôt galvanique de revêtements brillants, ductiles et nivelés en cuivre servant aussi bien à la décoration d'objets qu'au renforcement des pistes conductives de circuits imprimés. Ce bain se caractérise par le fait qu'il contient du dialkyléther de (poly)alkylèneglycol. Associés à des composés thiol contenant des groupes solubles dans l'eau, ces additifs permettent d'obtenir des électrolytes ayant une stabilité remarquable. On peut également y associer avec succès des composés supplémentaires de phénazonium, des composés polymères d'azote et/ou des composés thio azotés, selon les propriétés que l'on souhaite obtenir.

IPC 1-7

C25D 3/38

IPC 8 full level

C25D 3/38 (2006.01); **C25D 7/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C25D 3/38 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9303204A1

Designated contracting state (EPC)

AT DE ES FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

US 5433840 A 19950718; AT E131546 T1 19951215; CA 2115062 A1 19930218; CA 2115062 C 20051122; DE 4126502 C1 19930211; DE 59204703 D1 19960125; EP 0598763 A1 19940601; EP 0598763 B1 19951213; ES 2082486 T3 19960316; JP 3121346 B2 20001225; JP H07505187 A 19950608; WO 9303204 A1 19930218

DOCDB simple family (application)

US 19301694 A 19940406; AT 92916259 T 19920722; CA 2115062 A 19920722; DE 4126502 A 19910807; DE 59204703 T 19920722; DE 9200605 W 19920722; EP 92916259 A 19920722; ES 92916259 T 19920722; JP 50317193 A 19920722